

第 48 回 電子デバイス実装研究委員会



日時：2024 年 7 月 16 日（火）13:00～16:45

場所：日本橋ライフサイエンスビルディング 9 階 911-913 会議室（東京都中央区）

プログラム

司会 巽 裕章（大阪大学）

13:00～13:10 委員会議事

13:10～13:50

『マイクロトランスファープリンティングによる異種光機能材料集積』（40 分）

……………○鎌谷 淳一^{*1}, 古田 寛和^{*1}, 中村 将^{*1}, 岡本 慎也^{*1}, 久田 和也^{*1}, Maximilien BILLET^{*2}, Stijn CUYVERS^{*2}, Artur HERMANS^{*2}, Gunther ROELKENS^{*2}, Bart KUYKEN^{*2}, Sandeep Seema SASEENDRAN^{*3}, Philippe SOUSSAN^{*3}, Xavier ROTTENBERG^{*3}, Jon Ø. KJELLMAN^{*3}

(^{*1} パナソニックホールディングス(株), ^{*2} Photonics Research Group, Department of Information Technology, Ghent University – imec, ^{*3} imec)

13:50～14:30

『電気自動車の電費と経済性を改善するインバータ実装技術』（40 分）

……………○石井 利昭（日立 Astemo(株)）

14:30～14:45 休憩

司会 山内 啓（群馬工業高等専門学校）

14:45～15:25

『パワー半導体向け銅接合材の接合プロセスの検討』（40 分）

……………○川戸 祐一, 濱西 恭良, 有村 英俊（石原ケミカル(株)）

15:25～16:05

『高分散性と低温焼結性をもつサブミクロン銅粒子を用いた銅接合材の特性』（40 分）

……………○江山 誉昭, 稲家 修一, 鈴木 佑京, 福田 泰紀, 中西 亮, 武居 正史（花王(株)）

16:05～16:45

『高出力青色レーザー及び Blue/IR ハイブリッドレーザーによる銅加工技術と加工事例』（40 分）

……………○村山 太郎（古河電気工業(株)）

（ ）内時間は、質疑応答時間を含む

※プログラムは、都合により若干変更になることがありますので、予めご了承下さい。

※本研究委員会の資料を無断で転載、引用することを禁止します。

一般社団法人スマートプロセス学会 エレクトロニクス生産科学部会